

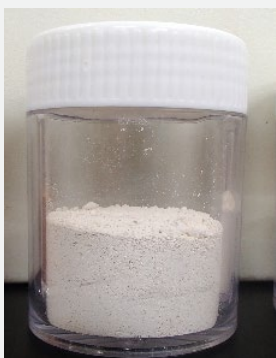
MIREK™

用途

- ・ 液晶ガラス、ハードディスク、フォトマスク等の研磨材
Abrasives for liquid crystal glass, hard disk, photomask, etc

概要・特徴

- ・ CeO₂砥粒により高レート、低ダメージな加工が可能
CeO₂ abrasive enable high-rate, low-damage processing.
- ・ 一次研磨から最終仕上げまで各用途に適した豊富なラインナップ
Multiple product lines suitable for wide application from primary to final polishing.



HLシリーズ



Eスラリー

品種	性状	平均粒径 (μm)	主な用途
		レーザー回折	
HL05	粉末	0.5~0.9	最終仕上げ用
HL10		0.8~1.3	最終仕上げ用
HL21		1.0~1.4	最終仕上げ用
HL30		1.2~1.7	1次研磨用
HL40		1.7~2.5	1次研磨用
E030CS	スラリー	0.2~0.3	最終仕上げ用
E020CS		0.1~0.2	最終仕上げ用
K020C		0.08~0.15	最終仕上げ用 コロイダルシリカ代替 /開発品